

天津金海通半导体设备股份有限公司 关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例、每股转增比例：向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4.50 股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如自议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本数量发生变动的，则公司拟维持每股分配比例、每股资本公积转增比例不变，相应调整现金分红、转增股份总额，调整后的利润分配方案无需再次提交董事会及股东会审议。

●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

●本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：公司所处的半导体专用设备制造领域，对于持续研发的需求较高，资金需求量较大。本次利润分配是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式、资金需求的综合考虑。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润 176,525,276.68 元，其中母公司实现净利润 190,126,272.31 元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提取法定盈余公积金后截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 621,360,576.53 元，资本公积余额为

913,289,420.01 元。经董事会决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、现金分红：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.38 元（含税）。截至 2026 年 3 月 9 日公司总股本 60,000,000 股，公司拟合计派发的现金分红总金额为 22,800,000.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 12.92%。

2、资本公积转增股本：公司拟向全体股东以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4.50 股。截至 2026 年 3 月 9 日，公司总股本为 60,000,000 股，本次以资本公积转增股本后，公司的总股本为 87,000,000 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。本次转增通过“资本公积——股本溢价”科目进行转增。

如自议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本数量发生变动的，则公司拟维持每股分配比例、每股资本公积转增比例不变，相应调整现金分红、转增股份总额，具体调整情况将另行公告，调整后的利润分配方案无需再次提交董事会及股东会审议。

本次利润分配方案尚需公司 2025 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在触及其他风险警示的情形。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	22,800,000.00	9,905,089.10	10,191,171.38
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	176,525,276.68	78,481,491.79	84,794,096.91
本年度末母公司报表未分配利润（元）	621,360,576.53		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	42,896,260.48		

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度平均净利润（元）	113,266,955.13
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	42,896,260.48
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	是
现金分红比例（%）	37.87
现金分红比例是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2025 年，公司实现归属于母公司所有者的净利润 176,525,276.68 元，公司拟分配的现金红利总额为 22,800,000.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司主要产品为集成电路测试分选机，属于集成电路专用设备领域的测试分选设备。集成电路行业是技术密集、知识密集的高科技行业，对测试设备技术要求较高。为保持技术的先进性和产品的竞争力，集成电路测试设备需要进行持续的研发，从研发、试产、质控到市场推广和销售的各阶段，需要投入较高人力成本及研发费用等经常性开支，资金需求量较大。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司处于成长阶段，公司将继续专注服务半导体封装测试行业，根据国家政策和战略发展需求，不断加强自主技术创新能力，努力拓宽客户群体和市场，积极促

进科技成果产业化。公司将继续加深与下游客户的合作，时刻把握市场动态，围绕自身技术优势，结合行业发展趋势，持续进行研发创新和技术升级。

（三）公司盈利水平及资金需求

2025年，公司实现归属于母公司所有者的净利润176,525,276.68元。公司业务仍在持续发展，为保障公司业务发展，公司有较高的资金需求。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司坚持稳健的利润分配政策，在制定每年的分红政策时，会综合平衡当年的利润分配对股东带来的短期价值回报和长期价值回报。本次利润分配方案是综合考虑了公司所处行业特点、自身发展阶段、日常营运资金需求等因素而做出的合理安排，兼顾了股东短期现金分红回报与中长期回报等因素，有利于公司长期稳健发展，不会损害投资者利益。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

留存未分配利润仍属于全体股东所有，将用于加强自主技术创新能力，努力拓宽客户群体和市场等，确保公司长期稳健发展，为股东创造长期稳定的回报。

（六）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东会决策提供便利。

（七）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将坚持提升软、硬件研发能力，完善研发体系，提高团队专业化程度，提升生产运营效率以及深化公司核心竞争力，积极履行公司的利润分配制度，重视以现金分红形式对投资者进行回报，为全体股东带来更多的回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于2026年3月9日召开第二届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案并修订<公司章程>的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策及股东回报规划，符合公司实际情况。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 3 月 10 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案并修订<公司章程>的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策及股东回报规划。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需公司 2025 年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 11 日